

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

M16C/62P、63、64、64A、65 グループ

フラッシュメモリ版 CPU 書き換えモードの比較

1. 要約

この資料は、M16C/62P グループと、M16C/63・M16C/64・M16C/64A・M16C/65 グループのフラッシュメモリ版 CPU 書き換えモードについて比較した内容を説明しています。

2. はじめに

この資料で説明する応用例は、次のマイコン、条件での利用に適用されます。

- ・マイコン： M16C/62P グループ
M16C/63 グループ
M16C/64 グループ
M16C/64A グループ
M16C/65 グループ

このアプリケーションノートのご使用に際しては、ハードウェアマニュアルの最新版を参照し、十分な評価を行ってください。

3. 概要比較

表 3.1にフラッシュメモリ版CPU書き換えモードに関する機能の相違点を示します。

表 3.1. 機能の相違点

項目		M16C/62P グループ	M16C/63,M16C/64,M16C/64A,M16C/65 グループ
フラッシュ関連レジスタ		FIDR,FMR0,FMR1	FMR0,FMR1,FMR2, FMR3(M16C/63のみ),FMR6,PRG2C
フラッシュ領域		ユーザ ROM データフラッシュ(ブロック A)	プログラム ROM1 プログラム ROM2 データフラッシュ(ブロック A,ブロック B)
EW0 モード時の使用レジスタと設定値		FMR01 ビット(注 1)= “1” FMR11 ビット(注 2)= “0”	FMR01 ビット(注 1)= “1” FMR11 ビット(注 2)= “1” FMR6 レジスタ= “02h”
EW1 モード時の使用レジスタと設定値		FMR01 ビット(注 1)= “1” FMR11 ビット(注 2)= “1”	FMR01 ビット(注 1)= “1” FMR11 ビット(注 2)= “1” FMR6 レジスタ= “03h”
ソフトウェア コマンド	プログラム	書き込み単位	1 ワード(2 バイト)単位
		コマンドコード	“xx40h”
	イレーズ全アンロックブロック	あり	なし
	ブロックブランクチェック	なし	あり
ユーザブート機能		なし	あり(FMR05 ビット= “1”)
サスペンド機能		なし	あり : M16C/63 なし : M16C/64,M16C/64A,M16C/65

注1. FMR01 ビット : FMR0 レジスタのビット 1

注2. FMR11 ビット : FMR1 レジスタのビット 1

4. 詳細比較

4.1 フラッシュ関連レジスタ比較

表 4.1にフラッシュ関連レジスタの相違点を示します。

表 4.1. フラッシュ関連レジスタの相違点

項目		M16C/62P グループ	M16C/63,M16C/64,M16C/64A,M16C/65 グループ
フラッシュメモリ 制御レジスタ 0 (FMR0)	FMR05 ビット	ユーザ ROM 領域選択ビット(注 1) 0 : ブート ROM 領域アクセス 1 : ユーザ ROM 領域アクセス	予約ビット ユーザブートモード以外では “0” にしてください。 ユーザブートモードでは “1” にしてください。
	FMR11 ビット	EW1 モード選択ビット 0 : EW0 モード 1 : EW1 モード	FMR6 レジスタへの書き込み許可ビット 0 : 禁止 1 : 許可
フラッシュメモリ 制御レジスタ 1 (FMR1)	FMR17 ビット	予約ビット	データフラッシュウェイトビット 0 : 1 ウェイト 1 : PM17 ビットに従う
	FMR22 ビット	なし	スローリードモード許可ビット 0 : 禁止 1 : 許可
フラッシュメモリ 制御レジスタ 2 (FMR2)	FMR23 ビット	なし	低消費電流リードモード許可ビット 0 : 禁止 1 : 許可
	FMR60 ビット	なし	EW1 モード選択ビット 0 : EW0 モード 1 : EW1 モード
プログラム 2 領域 制御レジスタ (PRG2C)	PRG2C0 ビット	なし	プログラム ROM2 無効ビット 0 : プログラム ROM2 有効 1 : プログラム ROM2 無効
	IRON ビット	なし	40000h~7FFFFh 番地のプログラム ROM1(注 2) 0 : 無効 1 : 有効

注1. ブートモード時のみ有効

注2. M16C/65 プログラム ROM1 が 512K バイトを超える製品にのみあるビットです。

4.2 フラッシュ領域のメモリ配置

フラッシュメモリの配置および、ブロックサイズが M16C/62P グループと、M16C/63・M16C/64・M16C/64A・M16C/65 グループで異なります。

表 4.2にフラッシュ領域のメモリ配置における相違点、図 4.1にメモリ配置の比較を示します。

表 4.2. フラッシュ領域のメモリ配置における相違点

項目		M16C/62P グループ	M16C/63,M16C/64,M16C/64A,M16C/65 グループ
データフラッシュ	ブロック A [4K バイト]	0F000h ~ 0FFFFh	0E000h ~ 0EFFFh
	ブロック B [4K バイト]	なし	0F000h ~ 0FFFFh
プログラム ROM	プログラム ROM1(注 1)	080000h ~ 0FFFFFFh(注 2)	080000h ~ 0FFFFFFh(注 2)
	プログラム ROM2	なし	010000h ~ 013FFFh(注 3)

注1. M16C/62P グループではユーザ ROM 領域

注2. 512K バイト版の場合

注3. PRG2C レジスタの PRG2C0 ビットが“0” (プログラム ROM2 有効) のとき使用できます。

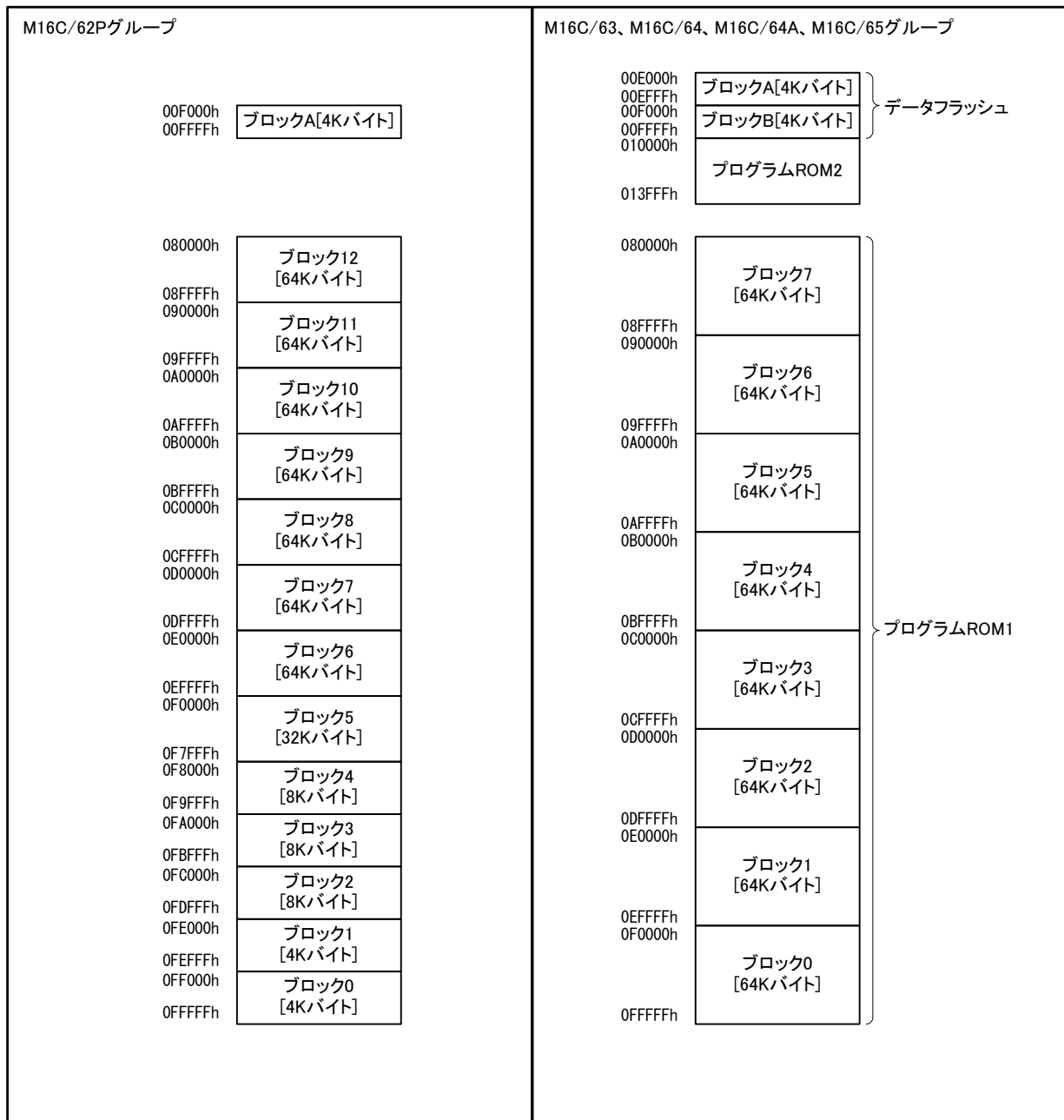


図 4.1 メモリ配置の比較(512K バイト版)

4.3 CPU 書き換えモード(EW0、EW1 モード)の設定と解除方法

図 4.2にCPU書き換えモード(EW0 モード)の設定と解除方法の比較、図 4.3にCPU書き換えモード(EW1 モード)の設定と解除方法の比較を示します。

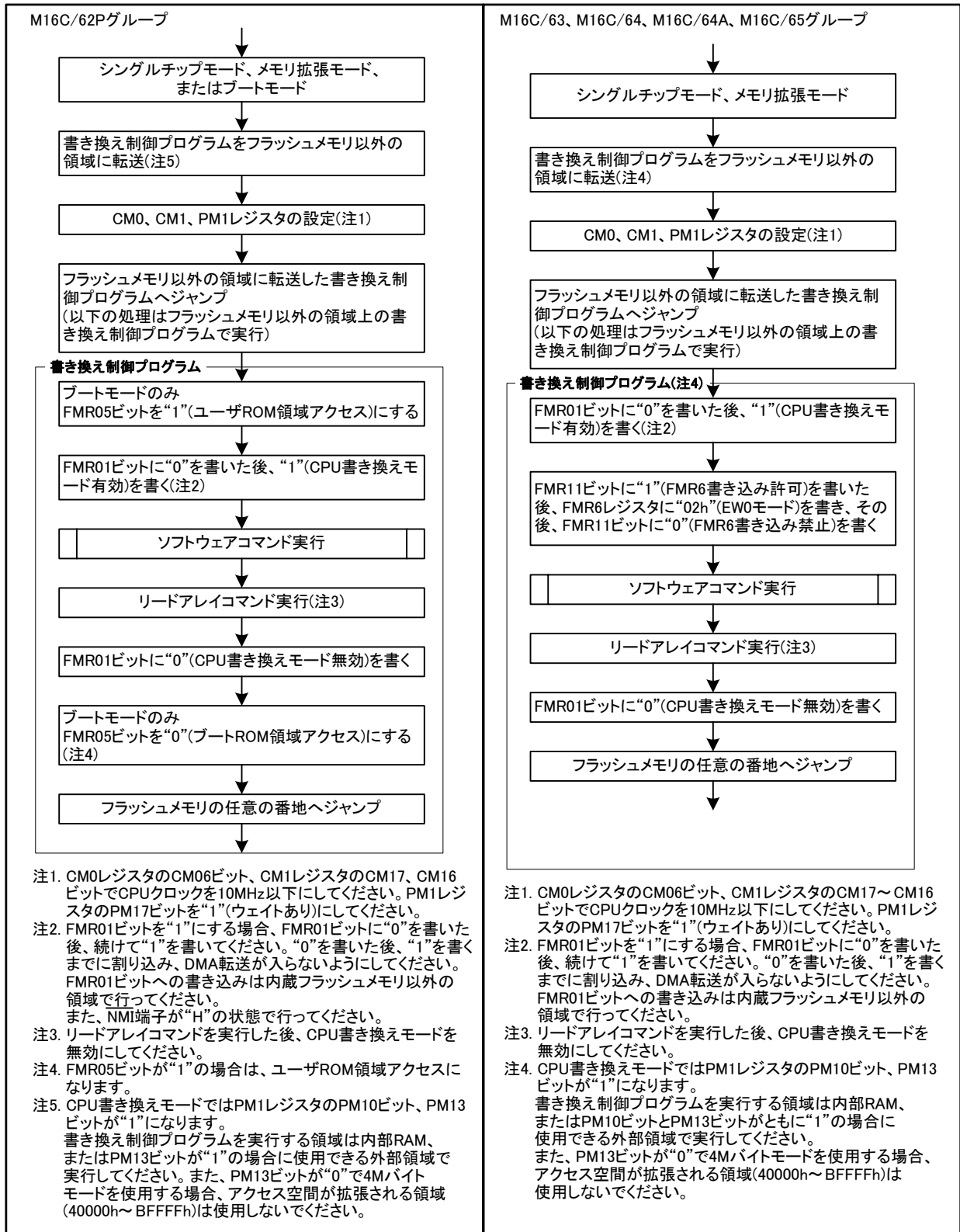


図 4.2 CPU 書き換えモード(EW0 モード)の設定と解除方法の比較

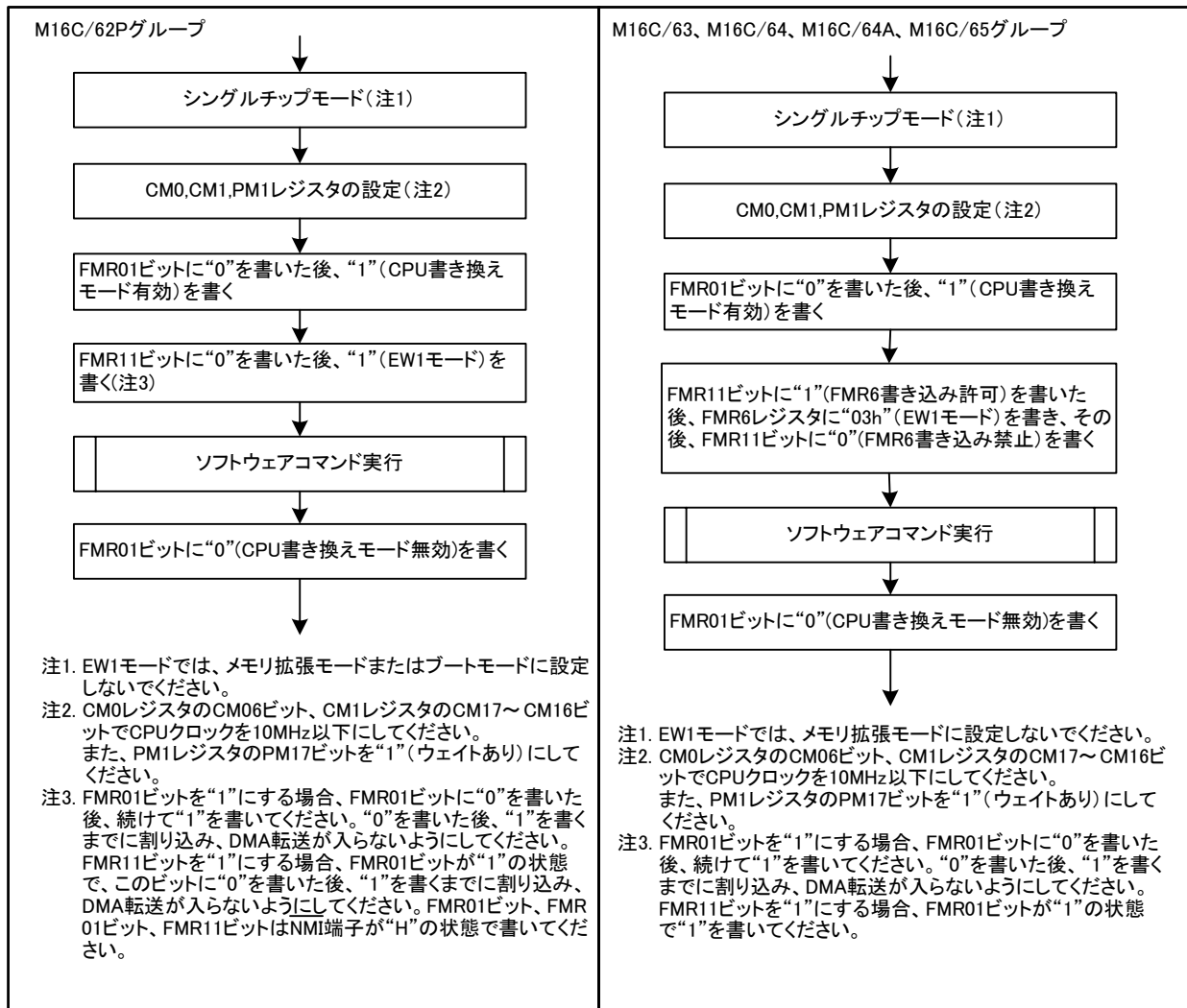


図 4.3 CPU 書き換えモード(EW1 モード)の設定と解除方法の比較

4.4 ソフトウェアコマンド比較

表 4.3にソフトウェアコマンドの相違点を示します。

表 4.3. ソフトウェアコマンドの相違点

ソフトウェア コマンド	マイコン	第1バスサイクル		第2バスサイクル		第3バスサイクル	
		アドレス	データ	アドレス	データ	アドレス	データ
リードアレイ	M16C/62P	X	XXFFh	—	—	—	—
	M16C/63,64, 64A,65(注1)	X	XXFFh	—	—	—	—
	M16C/65(注2)	B0-7	XXFFh	B8	XXFFh	—	—
リードステータス レジスタ	M16C/62P	X	XX70h	X	SRD	—	—
	M16C/63,64, 64A,65(注1)	X	XX70h	X	SRD	—	—
	M16C/65(注2)	BA	XX70h	X	SRD	—	—
クリアステータス レジスタ	M16C/62P	X	XX50h	—	—	—	—
	M16C/63,64, 64A,65(注1)	X	XX50h	—	—	—	—
	M16C/65(注2)	B0-7	XX50h	B8	XX50h	—	—
プログラム	M16C/62P	WA	XX40h	WA	WD	—	—
	M16C/63,64, 64A,65(注1)	WA	XX41h	WA	WD0	WA	WD1
	M16C/65(注2)	WA	XX41h	WA	WD0	WA	WD1
ブロックイレーズ	M16C/62P	X	XX20h	BA	XXD0h	—	—
	M16C/63,64, 64A,65(注1)	X	XX20h	BA	XXD0h	—	—
	M16C/65(注2)	BA	XX20h	BA	XXD0h	—	—
イレーズ 全アンロック ブロック	M16C/62P	X	XXA7h	X	XXD0h	—	—
	M16C/63,64, 64A,65(注1)	—	—	—	—	—	—
	M16C/65(注2)	—	—	—	—	—	—
リードロックビット ステータス	M16C/62P	X	XX71h	BA	XXD0h	—	—
	M16C/63,64, 64A,65(注1)	X	XX71h	BA	XXD0h	—	—
	M16C/65(注2)	BA	XX71h	BA	XXD0h	—	—
ブロックブランク チェック	M16C/62P	—	—	—	—	—	—
	M16C/63,64, 64A,65(注1)	X	XX25h	BA	XXD0h	—	—
	M16C/65(注2)	BA	XX25h	BA	XXD0h	—	—

注 1. M16C/65 プログラム ROM1 が 512K バイト以下の製品

注 2. M16C/65 プログラム ROM1 が 512K バイトを超える製品

SRD : ステータスレジスタデータ(D7~D0)

WA : 書き込み番地(偶数。ただし、M16C/63,64,64A,65 の場合、番地の末尾は、0h、4h、8h または Ch にしてください)

WD : 書き込みデータ(16 ビット)

WD0 : 書き込みデータ下位ワード(16 ビット)

WD1 : 書き込みデータ上位ワード(16 ビット)

BA : ブロックの最上位番地(ただし、偶数番地)

B0-7 : ブロック 0~7、プログラム ROM2、またはデータフラッシュ内の任意の偶数番地

B8 : ブロック 8 以降の任意の偶数番地

X : ユーザ ROM 領域内の任意の偶数番地

XX : コマンドの上位 8 ビット(無視されます)

4.5 プログラム

プログラムはM16C/62Pグループと、M16C/63・M16C/64・M16C/64A・M16C/65グループで異なります。
表 4.4にプログラムの相違点について示します。

表 4.4. プログラムの相違点

項目	M16C/62P グループ	M16C/63,M16C/64,M16C/64A,M16C/65 グループ
書き込み単位	1 ワード(2 バイト)単位	2 ワード(4 バイト)単位
コマンドコード	“xx40h”	“xx41h”

4.6 ユーザブート機能

M16C/63・M16C/64・M16C/64A・M16C/65グループではユーザブート機能が追加されており、任意のポートの状態、ブートモードとユーザブートモードを選択できます。

ユーザブート機能についてはハードウェアマニュアルを参照してください。

4.7 サスペンド機能

M16C/63グループではサスペンド機能が追加されており、自動消去、自動書き込みの途中で、これらの動作を一時中断する機能です。

サスペンド機能については M16C/63 のハードウェアマニュアルを参照してください。

5. 参考ドキュメント

ハードウェアマニュアル

M16C/62P グループハードウェアマニュアル

M16C/63 グループハードウェアマニュアル

M16C/64 グループハードウェアマニュアル

M16C/64A グループハードウェアマニュアル

M16C/65 グループハードウェアマニュアル

(最新版をルネサス テクノロジホームページから入手してください。)

テクニカルアップデート/テクニカルニュース

(最新の情報をルネサス テクノロジホームページから入手してください。)

ホームページとサポート窓口

ルネサス テクノロジM16Cホームページ

<http://japan.renesas.com/m16c>

ルネサス製品全般に関するお問い合わせ先

<http://japan.renesas.com/inquiry>

E-mail : csc@renesas.com

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2009.04.30	-	初版発行

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

本資料ご利用に際しての留意事項

1. 本資料は、お客様に用途に応じた適切な弊社製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報について弊社または第三者の知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾または保証するものではありません。
2. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例など全ての情報の使用に起因する損害、第三者の知的財産権その他の権利に対する侵害に関し、弊社は責任を負いません。
3. 本資料に記載の製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事情報の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替および外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
4. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの全ての情報は本資料発行時点のものであり、弊社は本資料に記載した製品または仕様等を予告なしに変更することがあります。弊社の半導体製品のご購入およびご使用に当たりましては、事前に弊社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、弊社ホームページ (<http://www.renesas.com>) などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
5. 本資料に記載した情報は、正確を期すため慎重に制作したのですが、万一本資料の記述の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、弊社はその責任を負いません。
6. 本資料に記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を流用する場合は、流用する情報を単独で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。弊社は、適用可否に対する責任を負いません。
7. 本資料に記載された製品は、各種安全装置や運輸・交通用、医療用、燃焼制御用、航空宇宙用、原子力、海中継用の機器・システムなど、その故障や誤動作が直接人命を脅かしあるいは人体に危害を及ぼすおそれのある機器・システムや特に高度な品質・信頼性が要求される機器・システムでの使用を意図して設計、製造されたものではありません（弊社が自動車用と指定する製品を自動車に使用する場合を除きます）。これらの用途に利用されることをご検討の際には、必ず事前に弊社営業窓口へご照会ください。なお、上記用途に使用されたことにより発生した損害等について弊社はその責任を負いかねますのでご了承願います。
8. 第7項にかかわらず、本資料に記載された製品は、下記の用途には使用しないでください。これらの用途に使用されたことにより発生した損害等につきましては、弊社は一切の責任を負いません。
 - 1) 生命維持装置。
 - 2) 人体に埋め込み使用するもの。
 - 3) 治療行為（患部切り出し、薬剤投与等）を行うもの。
 - 4) その他、直接人命に影響を与えるもの。
9. 本資料に記載された製品のご使用につき、特に最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件およびその他諸条件につきましては、弊社保証範囲内でご使用ください。弊社保証値を越えて製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、弊社はその責任を負いません。
10. 弊社は製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、特に半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。弊社製品の故障または誤動作が生じた場合も人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないよう、お客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計（含むハードウェアおよびソフトウェア）およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特にマイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
11. 本資料に記載の製品は、これを搭載した製品から剥がれた場合、幼児が口に入れて誤飲する等の事故の危険性があります。お客様の製品への実装後に容易に本製品が剥がれることがなきよう、お客様の責任において十分な安全設計をお願いします。お客様の製品から剥がれた場合の事故につきましては、弊社はその責任を負いません。
12. 本資料の全部または一部を弊社の文書による事前の承諾なしに転載または複製することを固くお断りいたします。
13. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点等がございましたら弊社営業窓口までご照会ください。

D039444